

# 非近眼显示

富采与合作伙伴致力于引领显示产业的发展趋势和技术前沿。包含现有显示方案的提升，持续推动技术创新，提升显示质量、降低功耗，并实现更高的性能和可靠性。Micro LED技术作为我们发展的重点之一，正逐步走向量产阶段，为用户带来更加震撼的视觉体验。而在未来的显示技术方面，我们不断探索新的技术路径和应用场景，为用户带来更加前沿、智能的显示解决方案。无论是虚拟现实、扩增实境等领域，富采都将成为您的首选合作伙伴，为产业提供最具竞争力的先进显示技术和产品。

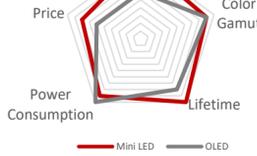
## Mini LED COB 背光应用于笔记本电脑

### 市场趋势与潜力

随着新媒体的兴起，创作者为增加作品的精准度、效率和效果，高规格的笔电屏幕需求逐渐提升。以Mini COB为背光的笔电，具备高色域、高亮度、高对比度之特性，有助于准确呈现色彩和细节，提升创作者的工作体验，确保作品质量。

### 富采亮点

- 采用蓝光直下式背光模块，可达到高色域、高亮度、高对比度的显示效果
- 搭载2000区分区调光技术，更细致的局部区域调光，实现画面细节，同时减少功耗更加节能



### 与富采一起驱动未来

产品/技术	外延片	芯片	封装	模块
	●	●	●	●

## 低蓝光背光应用于屏幕

### 市场趋势与潜力

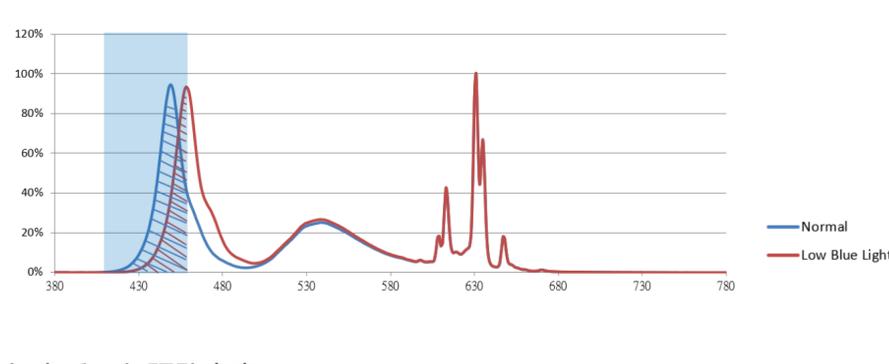
随着生活形态的改变，人们对显示器需求日益扩大，使用时间拉长，现代用户对视觉健康关注度也因此大幅提升，低蓝光产品同时满足健康与专业性趋势的使用者需求。

### 富采亮点

- 应用于23.8英寸屏幕的低蓝光背光，符合TÜV第2级蓝光标准，减少眼睛疲劳，确保长时间使用仍然高效舒适。



### 波长比较



### 与富采一起驱动未来

产品/技术	外延片	芯片	封装	模块
	●	●	●	●

## 智能显示

### 市场趋势与潜力

随着AIoT的蓬勃发展，消费性产品必须更智能化来满足消费者需求，其中，人机接口是很重要的沟通途径，透明且可挠的彩色显示器使外观设计师有更多的设计空间来制作出独特的商品。



### 富采亮点

- 软板透明RGB LED智能显示产品结合微型主动式IC，简化电路并提高穿透率
- 可应用于消费性电子产品，并克制曲度，为产品提供独特且有型的外观设计。

### 与富采一起驱动未来

产品/技术	外延片	芯片	封装	模块
	●	●	●	●

## QD LED 背光应用于32" 显示器

### 市场趋势与潜力

因显示器高对比度度及低电耗之特性，再加上容易导入而被广泛采用，于各场域应用皆有增加的趋势，包含教育、智能家电、户外广告、智慧零售，与传统技术相比，除了具有节能之优势，更可减少纸张的使用，符合ESG趋势。结合富采QD LED技术更能强化其色彩与亮度表现。

### 富采亮点

- 藉由QD LED的应用，强化显示器色彩、亮度及节能等特性，并达到广色域之效果，在不同环境中呈现更逼真影像。



### 与富采一起驱动未来

产品/技术	外延片	芯片	封装	模块
	●	●	●	●

## Micro LED

### 市场趋势与潜力

Micro LED技术可制造更小、更轻便的显示器并且具备模块化特性，使其持续受到不同市场的青睐，随着Micro LED技术能力提升和制造成本下降，Micro LED在高端显示市场的应用不断扩展。从非透明的室内/户外公共信息显示器(PID)、大尺寸消费性电视、穿戴装置，到逐渐导入透明屏的交通工具，Micro LED的应用范围正在逐步扩大。

### 6" COW

- 高波长均匀性及高效率Micro LED COW技术，提高Micro LED 终端产品色彩一致性、亮度。

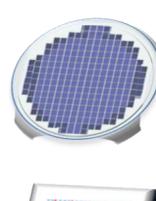
波長 (nm)	R: 620, G: 530, B: 460
晶粒尺寸 (µm)	13x28



### COC1+

- COC1+是Micro LED技术的重要发展，利用AI分类技术实现高度均匀，确保Micro LED显示器的品质。

- 对于显示器制造商而言，此技术无需设备或原有技术的调整，即可强化生产效率 and 产品质量，缩短生产时程。



### i-Pixel™ & i-Pixel+™

- 首创「低碳制程」晶圆级封装技术，集成Micro LED和Micro IC于单一0202 RGB封装中，将独家专利的i-Pixel™驱动方式由被动进化为主动（称为i-Pixel+™），充分发挥LED的低能耗特性，适用于高亮度透明显示屏，并具备可拼接的优势。



間距 (mm)	0.937
解析度 (pixel)	1080 x 1920
尺寸 (inch)	80



間距 (mm)	0.68
背光	Glass
解析度 (pixel)	160 x 320
亮度 (nits)	2000
开口率	75%

产品/技术	外延片	芯片	封装(i-Pixel™)	模块(i-Pixel+™)
	●	●	●	●